

SLG-500 2D锡膏测厚仪

产品名称	SLG-500 2D锡膏测厚仪
公司名称	苏州申奇电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区
联系电话	86-13382198699 13382198699

产品详情

UBand SLG-500锡膏测厚仪

非接触式激光测厚仪是由专用激光器产生线型光束，以一定的倾角投射到待测量目标（锡膏）上，因为待测目标与周围基板存在高度差，此时观测到的目标和基板上的激光束相应出现断续落差，如图1-1所示。根据三角函数关系可以通过该落差间距计算出待测目标截面与周围基板的高度差，从而实现非接触式的快速测量。

产品特性

1. Windows视窗界面，操作简单；
2. 测量值可记录存档及打印；
3. 测量数值准确无误；
4. 可随电路板厚度的不同调整焦距；
5. 机身小巧灵活，移动方便。

适用：

1. 各种厚度、宽度与长度的测量与统计分析；
2. 锡膏印刷制程品管的检查；
3. 锡膏印刷成型后的尺寸量测；
4. 在允许测量范围内同样适用与其它物品的测量与检验；

功能：

1. 测量厚度、长度、宽度、间距、直径、角度；
2. 提供高度分布数值；
3. 不同锡膏厚度的分析与控制；
4. 测量结果的单点及多点列表；
5. X-Bar管制图，Range管制图；
6. Cp，Cpk管制图及统计报表。

规格参数：（桌面式）

测量原理：非接触红外线镭射光源

可视范围：6.4 X 5.1 mm 检测范围：高度,长度,角度,圆周 光源：LED

工作台尺寸：480 x 500mm

重复测量精度：0.001mm

相机：320万（CCD相机）高色素彩色相机

电脑：Intel Duo Core, Windows O/S

单位：Inch, mm, mils, Microns

统计表：X-Bar, Range, Cp, Cpk

电源：AC 200V ~ 240V, single phase, 50/60Hz, 达式

环境：温度: 10 ~ 40 ° C, 湿度: 30 ~ 80% RH

尺寸：(W x D x H) 480 x 450 x 300 mm (L*W*H)

软件需求：

Windows 2000 (Service Pack 4) , Windows XP (Service Pack 1)

软件操作界面

这是一个基于检查和测量的工具。它通过X,Y和Z轴进行测量，通过Z轴测量的数据将实时统计到SPC结果中。它允许导出数据(文本或Excel格式)和图片。用户可以自行设置任意产品类型的SPC极限。通过对产品进行测量, 所得结果与对应产品类型的SPC极限比较, 给出' Pass'(通过) 或 ' Fail' (失败) 结果。除标准的X,Y和Z测量容易掌握外, 还提供几何测量功能, 它能使直径和角度测量更快, 更容易！